

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3080

जिसका उत्तर 11 मार्च, 2026 को दिया जाना है।

20 फाल्गुन, 1947 (शक)

भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0

3080. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू सेमीकंडक्टर और प्रदर्शन विनिर्माण परितंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए आम बजट 2026 में 'भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 2.0' की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय परिव्यय, लक्षित क्षेत्रों (फैब्स, एटीएमपी/ओएसएटी, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, डिजाइन-संबद्ध प्रोत्साहन) और प्रस्तावित कार्यान्वयन समय-सीमा क्या है और योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईएसएम 2.0 पिछले चरण की तुलना में बेहतर वित्तीय प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी भागीदारी या अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) सहायता प्रदान करता है;

(घ) नए चरण के तहत अनुमोदित या प्रस्तावित सेमीकंडक्टर विनिर्माण और असेंबली इकाइयों की संख्या कितनी है और उनके प्रस्तावित स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या तमिलनाडु राज्य में किसी सुविधा का प्रस्ताव है और उससे होने वाले अपेक्षित रोजगार सृजन का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा आईएसएम 2.0 के अंतर्गत आपूर्ति श्रृंखला संबंधी सुनम्यता, कुशल जनशक्ति विकास और दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (च): सेमीकंडक्टर विकास रणनीति माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण से प्रेरित है।

इस रणनीति के भाग के रूप में, सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैनुफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया, ताकि प्रतिभा पूल, डिजाइन, फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग, पैकिंग और मॉड्यूल निर्माण से लेकर एक संपूर्ण इकोसिस्टम विकसित किया जा सके।

उपलब्धियां:

तीन वर्ष की छोटी सी अवधि में, इसने लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धता अवलोकित की है।

- 2 फैब और 8 एटीएमपी/ओएसएटी सहित 10 इकाइयों को मंजूरी दी गई है और निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है
- एक इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन और 3 इकाइयों में पायलट उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है

- इन परियोजनाओं से पैकेजिंग सुविधाओं से 24 बिलियन से अधिक चिप्स/वर्ष, फैब्रिकेशन सुविधाओं से प्रति माह 55000 वेफर स्टार्ट (डब्ल्यूएसपीएम) का उत्पादन होने की उम्मीद है
- सेमीकंडक्टर चिप्स और एसओसी के डिजाइन के लिए 24 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनकी कुल परियोजना मूल्य 900 करोड़ रुपये है, जिसमें डिजाइन बुनियादी ढांचे में निवेश भी शामिल है
 - ये परियोजनाएं वीडियो निगरानी, ड्रोन का पता लगाने, ऊर्जा मीटरिंग, माइक्रोप्रोसेसर, उपग्रह संचार और ब्रॉडबैंड और आईओटी एसओसी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करती हैं।
 - 24 परियोजनाओं में से, 14 कंपनियों ने अपने समाधानों को बढ़ाने और उत्पाद बनाने के लिए वेंचर कैपिटल फंडिंग जुटाई है, जिससे निजी निवेश को 3 गुना से अधिक प्रोत्साहनों पर उत्प्रेरित किया गया है
 - भारतीय सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स द्वारा वीसी फंडिंग में 650 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं
 - कई फाउंड्री में टेप किए गए 16 डिजाइनों में से 7 चिप्स को सफलतापूर्वक तैयार किया गया है, जिसमें टीएसएमसी में 12 एनएम जैसे उन्नत नोड्स शामिल हैं
- 105 फैबलेस चिप डिजाइन कंपनियों को उन्नत चिप डिजाइन बुनियादी ढांचे तक पहुंच के साथ समर्थन दिया गया है, जो संचयी रूप से 60 लाख घंटे के उपकरण उपयोग की खपत करती हैं
- 315 विश्वविद्यालय छात्रों के लिए उन्नत ईडीए उपकरणों तक पहुंच प्राप्त कर रहे हैं। अब तक इनका उपयोग 185 लाख घंटे से अधिक हो चुका है
- पूरे भारत में 49 संस्थानों द्वारा 146 डिजाइन तैयार किए गए हैं, जिनमें से एससीएल ने 94 छात्र-डिजाइन किए गए चिप्स का सफलतापूर्वक निर्माण और पैकेजिंग की है

सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम की सफलता के आधार पर, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषणा की गई है जिसके तहत बताया गया कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को उपकरण और सामग्री का उत्पादन करने, फुल स्टैक डिजाइन करने, भारतीय आईपी डिजाइन करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए शुरू किया जाएगा।

योजना के विवरण तैयार किए जा रहे हैं।
